2008-2009年中国半导体材料行业市场分析研究咨询报告

报告大纲

观研报告网
www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2008-2009年中国半导体材料行业市场分析研究咨询报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：http://baogao.chinabaogao.com/bandaoti/77357735.html

报告价格：电子版: 6800元　纸介版：7300元　电子和纸介版: 7800

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sales@chinabaogao.com

联 系 人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

【英文版价】 15000元
【英文电子】 16000元
【英文两版】 17000元
→内容简介

随着以消费者为导向的应用爆炸式增长，半导体产业受到了极大驱动。半导体制造与封装越来越多地引入各种新材料，这为半导体材料供应商带来了许多商机。预测2008年全球半导体产业将增长4%，而全球半导体材料市场将增长9%，达461亿美元。在区域市场部分,日本在雄厚的晶圆制造和封装市场基础下，2008年以22%的占有率成为全球最大的材料市场,而台湾在过去四年晶圆和封装产业强劲成长的带动下,则成为第二大半导体材料市场。此外,总括新加坡、马来西亚、菲律宾、其它东南亚国家,以及小型全球市场则排名第三大。而大家关注的中国市场,在产能陆续开出之后,成为全球成长最快的半导体材料市场。

然而，目前我国半导体支撑材料业的发展很不平衡，与国际高科技产品相比较还存在一些差距。因此，国内半导体材料企业应该"苦练内功、夯实基础"，不断提高工艺水平，加强技术创新力度，让产品上档次，满足高端市场的需求。这样才不会忧虑国外厂商大举进入带来的激烈竞争，更不用担心国外先进技术带来的巨大冲击，反而可以吸引更多的大型厂商进入国内市场，形成一种良好的竞争机制与环境，促进半导体材料市场的健康发展以及国内电子信息产业企业的技术进步与产业升级。与半导体产业链上其他环节相比，国家对半导体材料产业的支持相对较弱，业界在不断呼吁，相关政策应尽快延伸到材料业。

在消费电子与绿色能源需求的推动下，新型半导体材料将更多地在生产中得到应用，新材料的使用同时也是降低成本的需求。此外，新的工艺技术也会对材料提出新的要求。预计到2010年或2014年，硅材料的技术和产业发展将走向极限，第二代和第三代半导体技术和产业将成为研究和发展的重点。政府决策部门、半导体科研单位和企业在现有的技术、市场和发展趋势面前应把握历史机遇，迎接挑战。

本报告对国内外半导体材料行业的发展状况进行了深入透彻地研究，对我国半导体材料主要市场发展情况、投资机会作了详尽分析。报告重点分析了下游半导体行业发展情况，报告还对国内重点半导体材料企业及未来半导体材料发展趋势进行了分析，是半导体材料及相关制造企业、投资部门、研究机构准确了解目前中国市场发展动态，把握半导体材料行业发展方向，为企业经营决策提供重要参考的依据。

→报告目录

目 录

第一章 半导体材料概述 1
第一节 半导体材料的概述 1
一、半导体材料的定义 1
二、半导体材料的分类 2
三、半导体材料的特点 3
四、化合物半导体材料介绍 4
第二节 半导体材料特性和制备 6
一、半导体材料特性和参数 6
二、半导体材料制备 7
第二章 世界半导体材料市场概况 9
第一节 世界总体市场概况 9
一、全球半导体材料的进展分析 9
二、全球半导体材料市场发展现状 11
三、第二代半导体材料砷化镓发展概况 12
四、第三代半导体材料GaN发展概况 13
第二节 北美半导体材料发展分析 14
一、北美半导体设备与材料市场 14
二、美国新半导体材料开发分析 16
三、美国道康宁在半导体材料方面的研究进展 17
四、2011年美国半导体材料市场发展预测 19
第三节 亚洲半导体材料发展 20
一、日本半导体新材料分析 20
二、韩国半导体材料产业分析 20
三、台湾半导体材料市场分析 22
第四节 世界半导体材料行业发展趋势 23
一、世界半导体材料发展趋势 23
二、2008年全球半导体材料市场分析 30
三、2011年世界半导体封装材料发展预测 31
第三章 中国半导体材料行业概况 33
第一节 行业发展概况 33
一、半导体材料的发展概况 33
二、半导体封装材料行业分析 36
三、半导体硅材料发展现状 44

四、国内半导体材料创新发展分析 46
五、半导体支撑材料发展瓶颈分析 49
第二节 中国半导体材料进出口状况 53
一、2008年半导体材料进口分析 53
二、2008年半导体材料出口分析 55
第三节 半导体材料技术发展分析 57
一、新材料研发投入分析 58
二、最大半导体材料市场分析 58
三、新材料与新工艺需求分析 59
四、半导体材料竞争无线应用领域 60
五、SOI技术发展分析 64
第四节 半导体材料技术动向及挑战 67
一、铜导线材料 67
二、硅绝缘材料 69
三、低介电质材料 69
四、高介电质、应变硅 70
五、太阳能板 71
六、无线射频 71
七、发光二极管 72
第四章 主要半导体材料发展概况 75
第一节 硅晶体 75
一、国内外多晶硅产业概况 75
二、单晶硅和外延片发展概况 82
三、中国硅晶体材料产业特点 84
四、我国多晶硅产业发展现状分析 85
五、2009-2010年多晶硅行业发展趋势 88
第二节 砷化镓 90
一、砷化镓产业发展概况 90
二、砷化镓材料发展概况 95
三、我国砷化镓产业链发展情况分析 97
四、砷化镓产业需求分析 99
第三节 GaN 100
一、GaN材料的特性与应用 100
二、GaN的应用前景 106
三、GaN市场发展现状 106

四、GaN产业市场投资前景 107
第四节 碳化硅 109
一、碳化硅概况 109
二、碳化硅生产企业分析 110
三、国内碳化硅晶体发展情况 113
四、2008-2010年碳化硅市场发展趋势 115
第五节 其他半导体材料 117
一、非晶半导体材料概况 117
二、宽禁带氮化镓材料发展概况 119
三、可印式氧化物半导体材料技术发展 123
第五章 半导体行业发展情况 131
第一节 国内外半导体产业发展情况 131
一、国内外半导体产业发展概况 131
二、中国内地半导体产业发展环境分析 135
三、2008年全球半导体行业发展态势分析 144
四、半导体企业竞争策略 157
五、2008年奥运会后的世界半导体市场 159
第二节 半导体市场发展预测 162
一、2008年中国半导体市场增长预测 162
二、2009年半导体产业发展预测 164
三、2008-2010年半导体产业预测 165
第六章 主要半导体市场发展概况 168
第一节 LED产业发展 168
一、全球LED产业发展概况 168
二、中国LED产业发展概况 192
三、我国半导体照明市场应用情况 206
四、2008年LED产业资源整合分析 211
五、2008-2010年中国LED产业发展预测 214
第二节 电子元器件市场 217
一、我国电子元器件产业发展前景分析 217
二、电子元件产业升级分析 221
三、2008年电子元器件收入利润分析 224
四、2008年电子元器件市场渠道供应趋势分析 225
五、2010年电子元器件市场预测 232
第三节 集成电路 232

一、2008年半导体集成电路产量分析 232
二、2008年中国集成电路市场运行分析 238
三、2010年集成电路产业的总体发展趋势 242
四、2011年我国集成电路市场规模预测 243
五、未来集成电路技术发展趋势 244
第四节 半导体分立器件 246
一、2008年半导体分立器件产量分析 246
二、2008年半导体器件进出口分析 253
三、2008年半导体分立器件市场发展态势 254
四、2008年半导体分立器件市场预测 254
第五节 其他半导体市场 258
一、半导体气体与化学品产业发展概况 258
二、IC光罩市场发展概况 259
第七章 半导体材料主要生产商简介 261
第一节 有研半导体材料股份有限公司 261
一、公司概况 261
二、2008年公司经营情况 263
三、2008年公司动态 269
第二节 天津中环半导体股份有限公司 271
一、公司概况 271
二、2008年公司经营情况 272
三、2008年公司动态 278
第三节 峨嵋半导体材料厂 281
一、公司概况 281
二、公司发展成就 282
第四节 四川新光硅业科技有限责任公司 286
一、公司概况 286
二、2008年公司动态 288
第五节 洛阳中硅高科技有限公司 288
一、公司概况 288
二、公司技术研发分析 290
第六节 宁波立立电子股份有限公司 291
一、公司概况 291
二、公司产品及技术研发 292
三、2008年公司动态 293

第七节 宁波康强电子股份有限公司 294
一、公司概况 294
二、2008年公司经营情况 295
第八节 南京国盛电子有限公司 298
一、公司概况 298
二、工艺技术与产品 299
第八章 半导体材料发展趋势 301
第一节 半导体材料发展预测 301
一、2008-2009年全球半导体材料市场成长率预测 301
二、2009-2010年化合物半导体材料市场预测 304
三、2010年中国半导体材料产业发展前景 304
四、2010年半导体材料销售额预测 305
五、未来半导体材料发展趋势 308
第二节 主要半导体材料的发展趋势 309
一、硅材料 309
二、GaAs和InP单晶材料 310
三、半导体超晶格、量子阱材料 310
四、一维量子线、零维量子点半导体微结构材料 313
五、宽带隙半导体材料 314
六、光子晶体 316
七、量子比特构建与材料 316
第九章 半导体材料投资及建议 318
第一节 半导体材料投资市场分析 318
一、国内企业投资多晶硅形势分析 318
二、2008年全球半导体投资市场分析 320
三、半导体产业投资模式变革分析 321
四、半导体领域风险投资困境分析 324
五、半导体新材料表征面临的挑战 324
六、半导体玻璃应用前景分析 330
第二节 2008年中国半导体行业投资分析 332
一、2008年中国半导体投资风险 332
二、2008年中国半导体业机会 332
三、2008-2009年中国半导体投资预测 333
第三节 发展我国半导体材料的建议 334
一、硅单晶和外延材料 334

二、GaAs及其有关化合物半导体单晶材料发展建议 334
三、发展超晶格、零维半导体微结构材料建议 334

图表目录

图表：元素半导体的性质与结构 4
图表：III-Ⅴ化合物半导体的性质 5
图表：Ⅱ-VI化合物半导体的性质 5
图表：部分二元化合物半导体的性质 5
图表：CZT薄膜的能隙Eg与组分的关系 6
图表：半导体用材料的定义及范围 9
图表：2006-2009年全球电子级硅片总消耗量预测 10
图表：2006-2008年管芯制造材料预测 11
图表：2005年全球半导体材料市场规模 11
图表：2008-2009年全球半导体材料市场规模预测 15
图表：2000-2007年全球Fab产能分布的变化 23
图表：2007年半导体材料市场分布统计 24
图表：High-k/metalgate材料技术的演进发展 25
图表：Dualmetal与Dualhigh-k的比较 26
图表：藉由电极矩改变Gate的功函数 28
图表：在金属闸极中添加不纯物 28
图表：主要半导体材料的比较 34
图表：半导体材料的主要用途 35
图表：2001-2005年中国半导体封装材料市场规模及增长 36
图表：2005年中国半导体封装材料市场结构 37
图表：2005年国内半导体引线框架制造企业产能分布及市场份额 39
图表：2005年国内金丝生产企业市场份额 40
图表：现代微电子工业对硅片关键参数的要求 46
图表：2008年1月全国半导体器件和已装配的压电晶体进口分析 53
图表：2008年2月全国半导体器件和已装配的压电晶体进口分析 53
图表：2008年3月全国半导体器件和已装配的压电晶体进口分析 53
图表：2008年1季度全国半导体器件和已装配的压电晶体进口分析 53
图表：2008年4月全国半导体器件和已装配的压电晶体进口分析 54
图表：2008年5月全国半导体器件和已装配的压电晶体进口分析 54
图表：2008年6月全国半导体器件和已装配的压电晶体进口分析 54
图表：2008年2季度全国半导体器件和已装配的压电晶体进口分析 54

图表：2008年7月全国半导体器件和已装配的压电晶体进口分析 54
图表：2008年8月全国半导体器件和已装配的压电晶体进口分析 55
图表：2008年1-8月全国半导体器件和已装配的压电晶体进口分析 55
图表：2008年1月全国半导体器件和已装配的压电晶体出口分析 55
图表：2008年2月全国半导体器件和已装配的压电晶体出口分析 55
图表：2008年3月全国半导体器件和已装配的压电晶体出口分析 55
图表：2008年1季度全国半导体器件和已装配的压电晶体出口分析 56
图表：2008年4月全国半导体器件和已装配的压电晶体出口分析 56
图表：2008年5月全国半导体器件和已装配的压电晶体出口分析 56
图表：2008年6月全国半导体器件和已装配的压电晶体出口分析 56
图表：2008年2季度全国半导体器件和已装配的压电晶体出口分析 56
图表：2008年7月全国半导体器件和已装配的压电晶体出口分析 57
图表：2008年8月全国半导体器件和已装配的压电晶体出口分析 57
图表：2008年1-8月全国半导体器件和已装配的压电晶体出口分析 57
图表：1998年IBM公司使用自有的CMOS7S制程技术来产制的芯片 68
图表：High-k材料与SiO2材料比较 70
图表：德国西门子公司用单晶硅材料制成的太阳能基板 71
图表：常见的LED发光材料 72
图表：红光LED的照射使植物（农作物）增长图 73
图表：2002-2010年全球及中国太阳能级多晶硅需求量统计及预测 76
图表：2005-2010年全球太阳能电池产量统计与预测 77
图表：2005年世界主要多晶硅生产企业产能及生产情况 78
图表：2003-2006年国内多晶硅生产产量趋势图 79
图表：多晶硅质量指标 81
图表：砷化镓与硅的组件特性比较 90
图表：砷化镓微波三种元件结构之特性的比较 91
图表：砷化镓产业上下游关联图 93
图表：砷化镓微波组件的商业运用 94
图表：GaAs单晶生产方法比较 95
图表：世界GaAs单晶主要生产厂家 96
图表：钎锌矿GaN和闪锌矿GaN的特性 100
图表：双气流MOCVD生长GaN装置 103
图表：GaN基器件与CaAs及SiC器件的性能比较 104
图表：以发光效率为标志的LED发展历程 104
图表：不同碳化硅类型情况简介 109

图表：碳化硅晶片生产及应用前景情况 110
图表：碳化硅晶片生产企业情况 111
图表：碳化硅晶片生产工艺 112
图表：SiC器件的研究概表 120
图表：非晶型氧化铟镓锌材料系统组成比例(右)与电子迁移率(左) 124
图表：五种基本的印制方式 125
图表：典型传统印制技术应用之基材种类与印制材料及其最小线宽 126
图表：软式微影技术的组件制作流程 127
图表：高分辨率软式微影技术压印头印制250nm×250nm方柱图 128
图表：由100μm玻璃背板及30μm聚合物双层模块成具有270nm图案之压印头实例 128
图表：传统印制技术与软式微影技术相对应的比较 129
图表：全球半导体应用领域分布 131
图表：2005年全球半导体分类产品销售收入 132
图表：2006年排名前十位的半导体公司 132
图表：2003-2005年半导体市场向亚太地区转移 133
图表：我国集成电路生产线统计 138
图表：2006年我国内地IC封装测试企业收入前十名 139
图表：2008年6月全球半导体销售情况 145
图表：2000-2008年欧洲半导体月度销售额 145
图表：2000-2008年欧洲半导体各月销售额同比增长率 146
图表：2007年7月-2008年7月全球半导体销售额 146
图表：2007年7月-2008年7月全球半导体销售额同比和环比变化率 147
图表：2007年7月-2008年7月欧洲半导体销售额 147
图表：2007年7月-2008年7月欧洲半导体销售额同比和环比变化率 147
图表：2007年7月-2008年7月美国半导体销售额 148
图表：2007年7月-2008年7月美国半导体销售额同比和环比变化率 148
图表：2007年7月-2008年7月日本半导体销售额 149
图表：2007年7月-2008年7月日本半导体销售额同比和环比变化率 149
图表：2007年7月-2008年7月亚太地区半导体销售额 149
图表：2007年7月-2008年7月亚太地区半导体销售额同比和环比变化率 150
图表：2008年3-7月中国半导体销售额 150
图表：2007年8月-2008年8月全球半导体销售额 151
图表：2007年8月-2008年8月全球半导体销售额同比和环比变化率 151
图表：2007年8月-2008年8月欧洲半导体销售额 152
图表：2007年8月-2008年8月欧洲半导体销售额同比和环比变化率 152

图表：2007年8月-2008年8月美国半导体销售额 152
图表：2007年8月-2008年8月美国半导体销售额同比和环比变化率 153
图表：2007年8月-2008年8月日本半导体销售额 153
图表：2007年8月-2008年8月日本半导体销售额同比和环比变化率 153
图表：2007年8月-2008年8月亚太地区半导体销售额 154
图表：2007年8月-2008年8月亚太地区半导体销售额同比和环比变化率 154
图表：2008年3-8月中国半导体销售额 155
图表：2008年上半年半导体行业销售额排名 156
图表：2008年上半年半导体行业销售额增长率排名 156
图表：2008-2012年中国半导体市场营业收入预测 162
图表：2008-2012年在中国设计的主要电子产品的营业收入预测 163
图表：全球主要LED业者概况 169
图表：2011年全球LED市场成长预测 169
图表：全球高亮芯片主要应用领域分布（按销售额统计） 170
图表：全球高亮芯片主要应用领域分布（按销售量统计） 170
图表：全球主要LED领先厂商 175
图表：2006年全球主要LED大厂营运收入 175
图表：LED产业链投资规模估算 176
图表：国际半导体照明专利状况对比 176
图表：全球七大LED巨头专利数分布 176
图表：LED发光效率演进 185
图表：各种照明技术发光效率与光电转换效率变化 186
图表：LED基本分类与应用市场 188
图表：传统亮度与高亮度LED产品应用市场 189
图表：2006-2010年全球手机出货量预测 190
图表：各种手机用面板技术比较 191
图表：2006-2010LED背光模组出货趋势 191
图表：2003-2009年全球照明市场规模及预测 191
图表：2004-2006年蓝光LED芯片价格变化 192
图表：LED应用市场发展路线图 192
图表：2006年国内LED芯片市场分布图 194
图表：2008年全球LED应用领域分布情况 212
图表：国内主要LED产业基地及其核心企业 213
图表：2003-2010年国内GaN芯片产能发展预测 213
图表：国内LED产品的应用领域分布 213

图表：我国半导体照明产业中下游优劣势比较 214
图表：2008年的中国地区电子元器件市场业务平均增长幅度预测 225
图表：2008年元器件原厂的平均交货期有所缩短 228
图表：2008年电子元器件独立分销商开始将重点转向服务的提供 230
图表：电子元器件分销商提供小批量供应时所面临的主要挑战 231
图表：2008年2-8月半导体集成电路全国产量合计 232
图表：2008年2-8月半导体集成电路北京市产量合计 233
图表：2008年2-8月半导体集成电路天津市产量合计 233
图表：2008年2-8月半导体集成电路河北省产量合计 233
图表：2008年2-8月半导体集成电路辽宁省产量合计 234
图表：2008年2-8月半导体集成电路上海市产量合计 234
图表：2008年2-8月半导体集成电路江苏省产量合计 234
图表：2008年2-8月半导体集成电路浙江省产量合计 235
图表：2008年2-8月半导体集成电路福建省产量合计 235
图表：2008年2-8月半导体集成电路山东省产量合计 235
图表：2008年2-8月半导体集成电路河南省产量合计 236
图表：2008年2-8月半导体集成电路湖北省产量合计 236
图表：2008年2-8月半导体集成电路湖南省产量合计 236
图表：2008年2-8月半导体集成电路广东省产量合计 237
图表：2008年2-8月半导体集成电路重庆市产量合计 237
图表：2008年2-8月半导体集成电路四川省产量合计 237
图表：2008年2-8月半导体集成电路贵州省产量合计 238
图表：2008年2-8月半导体集成电路甘肃省产量合计 238
图表：2004-2008年上半年中国集成电路市场销售额规模及增长率 239
图表：2008年上半年中国集成电路市场各应用领域增长率 240
图表：2008年上半年中国集成电路市场应用结构 240
图表：2008年上半年中国集成电路市场产品结构 241
图表：2008年2-8月半导体分立器件全国产量合计 246
图表：2008年2-8月半导体分立器件北京市产量合计 246
图表：2008年2-8月半导体分立器件天津市产量合计 247
图表：2008年2-8月半导体分立器件河北省产量合计 247
图表：2008年2-8月半导体分立器件辽宁省产量合计 247
图表：2008年2-8月半导体分立器件吉林省产量合计 248
图表：2008年2-8月半导体分立器件黑龙江产量合计 248
图表：2008年2-8月半导体分立器件上海市产量合计 248

图表：2008年2-8月半导体分立器件江苏省产量合计 249
图表：2008年2-8月半导体分立器件浙江省产量合计 249
图表：2008年2-8月半导体分立器件安徽省产量合计 249
图表：2008年2-8月半导体分立器件福建省产量合计 250
图表：2008年2-8月半导体分立器件江西省产量合计 250
图表：2008年2-8月半导体分立器件山东省产量合计 250
图表：2008年2-8月半导体分立器件河南省产量合计 251
图表：2008年2-8月半导体分立器件湖北省产量合计 251
图表：2008年2-8月半导体分立器件湖南省产量合计 251
图表：2008年2-8月半导体分立器件广东省产量合计 252
图表：2008年2-8月半导体分立器件广西区产量合计 252
图表：2008年2-8月半导体分立器件四川省产量合计 252
图表：2008年2-8月半导体分立器件贵州省产量合计 253
图表：2008年2-8月半导体分立器件陕西省产量合计 253
图表：2008年全球分立器件终端产品市场预测 255
图表：2008年我国分立器件市场按产品结构细分预测 255
图表：半导体气体与化学品技术发展蓝图 259
图表：有研半导体材料股份有限公司200mm硅抛光片规格 262
图表：有研半导体材料股份有限公司150mm硅抛光片规格 262
图表：2008年2季度有研半导体材料股份有限公司主营构成表 264
图表：2007-2008年有研半导体材料股份有限公司每股指标 264
图表：2007-2008年有研半导体材料股份有限公司获利能力表 264
图表：2007-2008年有研半导体材料股份有限公司经营能力表 265
图表：2007-2008年有研半导体材料股份有限公司偿债能力表 265
图表：2007-2008年有研半导体材料股份有限公司资本结构表 265
图表：2007-2008年有研半导体材料股份有限公司发展能力表 265
图表：2007-2008年有研半导体材料股份有限公司现金流量分析表 266
图表：2007-2008年有研半导体材料股份有限公司利润分配表 266
图表：2008-2010年有研半导体材料股份有限公司资产负债表 267
图表：2008-2010年有研半导体材料股份有限公司现金流量表 268
图表：2008-2010年有研半导体材料股份有限公司利润表 268
图表：2008-2010年有研半导体材料股份有限公司财务指标 269
图表：天津中环半导体股份有限公司产品销售市场 271
图表：2008年上半年天津中环半导体股份有限公司收入情况 273
图表：2008年2季度天津中环半导体股份有限公司主营构成表 274

图表：2007-2008年天津中环半导体股份有限公司每股指标 274
图表：2007-2008年天津中环半导体股份有限公司获利能力表 274
图表：2007-2008年天津中环半导体股份有限公司经营能力表 275
图表：2007-2008年天津中环半导体股份有限公司偿债能力表 275
图表：2007-2008年天津中环半导体股份有限公司资本结构表 275
图表：2007-2008年天津中环半导体股份有限公司发展能力表 275
图表：2007-2008年天津中环半导体股份有限公司现金流量分析表 276
图表：2007-2008年天津中环半导体股份有限公司利润分配表 276
图表：2006-2009年天津中环半导体股份有限公司项目进度 277
图表：2008-2009年天津中环半导体股份有限公司利润表 277
图表：2008-2010年天津中环半导体股份有限公司基本财务状况 278
图表：2008年上半年天津中环半导体股份有限公司分业务情况 279
图表：2008年上半年天津中环半导体股份有限公司各项业务的经营情况 280
图表：2008年天津中环半导体股份有限公司业绩越来越多的依赖单晶硅 280
图表：天津中环半导体股份有限公司未来区熔单晶硅业务增长敏感性分析 281
图表：新光硅业公司股东及持股比例 287
图表：立立电子抛光片产品规格 292
图表：立立电子外延片产品规格 293
图表：2008年2季度宁波康强电子股份有限公司主营构成表 295
图表：2007-2008年宁波康强电子股份有限公司每股指标 295
图表：2007-2008年宁波康强电子股份有限公司获利能力表 296
图表：2007-2008年宁波康强电子股份有限公司经营能力表 296
图表：2007-2008年宁波康强电子股份有限公司偿债能力表 296
图表：2007-2008年宁波康强电子股份有限公司资本结构表 296
图表：2007-2008年宁波康强电子股份有限公司发展能力表 297
图表：2007-2008年宁波康强电子股份有限公司现金流量分析表 297
图表：2007-2008年宁波康强电子股份有限公司利润分配表 297
图表：2008年全球半导体材料市场规模 302
图表：中国半导体材料需求量 305
图表：2005-2006年我国多晶硅企业筹建、新建、扩建情况 318
略……
（如需详细目录，请来电索取）

详细请访问：http://baogao.chinabaogao.com/bandaoti/77357735.html